

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成22年4月15日(2010.4.15)

【公開番号】特開2009-158810(P2009-158810A)

【公開日】平成21年7月16日(2009.7.16)

【年通号数】公開・登録公報2009-028

【出願番号】特願2007-337248(P2007-337248)

【国際特許分類】

H 01 L 21/304 (2006.01)

B 24 B 37/00 (2006.01)

C 09 K 3/14 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/304 6 2 2 D

B 24 B 37/00 H

C 09 K 3/14 5 5 0 Z

C 09 K 3/14 5 5 0 D

【手続補正書】

【提出日】平成22年2月26日(2010.2.26)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0058

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0058】

このように、実施例1～5のCMP用スラリーは、比較例1～4のCMP用スラリーに対し、ファングの抑制効果およびスクラッチ数の低減効果に優れ、かつSiO₂膜(第2の絶縁膜)の研磨速度の向上効果、すなわちSiO₂膜を確実に削りきり、SiOC膜(第1の絶縁膜)を露出させる能力が高まっている。これは重量平均分子量が100万以上1000万以下のポリアクリル酸(水溶性高分子)と、-シクロデキストリンとを同時に用いることによって初めて得られる相乗的効果である。